



平成 24 年 11 月 12 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和  
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)  
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 岸本 昌利  
TEL (075) 692 - 0251

## 北米拠点での半導体・LED成形実験および評価サポート開始の件

北米の半導体・LEDメーカーの多くは、既に台湾、中国、東南アジアなど米国外に生産拠点・製造機能を移しておりますが、先端技術の開発や試作は今なおシリコンバレーを中心とした北米地域で行っております。また、製造設備を持たずシリコンサイクルの影響を受けにくいファブレスメーカーの台頭は目覚しく、独自のビジネスモデルに加えて、大手メーカーがドメイン（事業領域）から切り離れた非コア部門を買収する等により、さらに成長を続けています。

ファブレスメーカー各社においては、半導体・LEDパッケージの開発段階で、その量産移行後に組み立て工程を担う台湾・中国などアジアのOSAT各社との技術的な“すりあわせ”が重要となっています。当社を含めた製造装置メーカーにとっては、OSAT各社が求める製造装置の開発期間をさらに短期化するためには、この“すりあわせ”段階において概ね必要な要素技術を把握しておくことが必要となります。

このような背景から当社は、ファブレスメーカー各社が半導体・LEDの成形実験を適時に且つ、スピーディーに行えるよう、現地（北米拠点）にコンプレッション方式をはじめとするモールドング設備を常設し、あわせて万全の技術サポート体制を敷くことにより、お客様が本当に求めるものを“クォーター・リード”で創り出してまいります。

### 記

#### 1、導入する成形実験および評価用設備

コンプレッション方式・トランスファ方式によるモールドング実験・評価用プレス  
想定用途：高輝度LED、COB対応、3D-IC・ハイエンドIC（TSV、フリップチップなど）

#### 2、導入拠点

拠点名 : TOWA America Corporation  
所在地 : 350 Woodview Avenue, Suite 200, Morgan Hill, California 95037 U.S.A.

#### 3、成形実験・評価開始

2013年1月を予定

以上